



Power Assembly Engineer (パワーデバイスパッケージ)

募集職種

採用企業名

株式会社iSoftStone Japan

求人ID

1605945

業種

化学・素材

会社の種類

大手企業 (300名を超える従業員数) - 外資系企業

外国人の割合

外国人 半数

雇用形態

契約

勤務地

東京都 23区

給与

450万円 ~ 650万円

更新日

2026年09月10日 05:00

応募必要条件

職務経験

1年以上

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

日常会話レベル

日本語レベル

ビジネス会話レベル

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

1. 高度なパワーエンカプレーションシステム（材料およびプロセス）の開発を担当する
2. エンカプラー材料の専門家に対して、定期的なプロジェクトタスクの追跡をサポートできる
3. 材料の納品および分析作業において、専門家をサポートできる
4. 実験設計をサポートし、結果をまとめることができる

スキル・資格

More than 2 years related working experience in encapsulate material/equipment/process technology development.

